

次世代無添加物之聚合技術,大幅提升潔淨度

- 適合應用在乾式蝕刻製程，與濕式蝕刻製程。
適用之化學品如：HCl, HNO₃, HF等。並且對於大部分的有機溶劑、酸類與鹼類，均能表現出極優異且穩定之特性。
- 在氧化與電漿環境下,大幅減少微塵之產生。
- 能表現出優異的物理特性，並採用獨家專利之聚合技術
大幅提高裂解溫度性能(無氧環境TGA測試)。
- 連續使用溫度可達280°C
- 對於在鋁件接著應用上，搭配專利接著技術，
可應用於閉合閘門密封件(Bonded Gate Seals, Slit Valve Seals)
亦能充分表現出本產品之優異性能。
- 本產品之最後包裝與清潔均於無塵室內完成。



ea 特性與優點

適合應用於高溫乾式蝕刻製程
適合應用於濕式蝕刻製程
優異的電漿耐受性
極佳的化學耐受性
優異的產品物理特性
優異的壓縮變形率
最高連續使用溫度280°C
長時間、穩定並優異的高溫密封性能

ea 建議應用位置

反應槽密封件(Chamber Seals)
管線接頭密封件(Fitting Seals)
氣體管線密封件(Gas Inlet/Outlet Pumping Line Seals)
閥件密封件(Valve Seals)

ea 典型物理特性

| | |
|-------------------------|--------|
| 硬度(Shore A) | 72 |
| 顏色 | 透光深琥珀色 |
| 模數(100 % Modulus) | 4 |
| 拉伸強度(Tensile, MPa) | 10.2 |
| 延伸率(Elongation, %) | 240 |
| 壓縮變形率(%, 70 hr @ 250°C) | 21.2 |
| 最高連續使用溫度(°C) | 280 |

ea 建議應用製程

乾式蝕刻(Dry Etch)
濕式蝕刻(Wet Etch Acid,Base)
擴散(Diffusion)
離子植入(Ion Implant)
快速回火(RTP)
濕式去光阻(Wet Stripping Solvents)
濕式清潔(Wet Cleaning UPDI)